

# SR-HS

Höchstgeschwindigkeit  
beim Durchlöten

*The highest speed when  
soldering through hole*

Mit Höchstgeschwindigkeit zu löten und dabei trotzdem eine perfekte Stabilität und Konstanz beim Lötprozess zu bewahren – das ist eine der besonderen Qualitäten, die ein Almit Lotdraht mit SR-HS bietet. Überzeugen Sie sich selbst.

Auch von den weiteren Vorteilen, die SR-HS bietet: Hervorragende Benetzungseigenschaften und minimiertes Flussmittelspritzverhalten.

- ▶ ideal für Schleplöt-Prozesse
- ▶ hervorragende Benetzungseigenschaften
- ▶ minimiertes Spritzverhalten
- ▶ RoHS-konform

*Soldering at the highest speed while ensuring perfect stability and consistency in the soldering process – that is one of the special qualities that an Almit solder wire with SR-HS has to offer. See for yourself.*

*Amongst the other benefits that SR-HS offers, as for example excellent wetting properties and minimized flux splattering.*

- ▶ ideal for dragging solder processes
- ▶ excellent wetting properties
- ▶ minimizes flux splattering
- ▶ RoHS compliant



## SR-HS Spezifikation / Specification

Flussmittel Flux	Zusammensetzung Composition	Schmelzbereich Melting range	Flussmittelanteil Flux content
SR-HS	LFM-48 M (Sn-3.0Ag-0.5Cu-a)	217-221 °C	3.5%, 4.5%

SR-HS Lotdraht ist mit folgenden Durchmessern erhältlich / SR-HS solder wire is available with the following diameters: 0.3, 0.38, 0.5, 0.65, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6

## SR-HS im Vergleich / in comparison

### Schleplöt-Test / dragging solder test

Der Vergleich von einem Almit Lotdraht mit SR-HS zu einem herkömmlichen Lotdraht zeigt den Unterschied: klare, nahezu identische Lötunkte mit SR-HS.

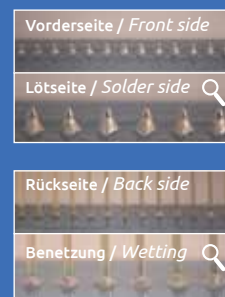
*The comparison between an Almit solder wire with SR-HS to a standard solder wire shows the difference: clear and almost identical solder points with SR-HS.*

### Test-Methode: Schleplöten durch Lötroboter auf Leiterplatte mit Steckerleiste

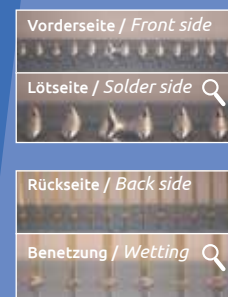
*Test method: drag soldering by an automatic machine onto a PW board with insert parts*

Lötkolbentemperatur / Solder iron temperature	360 °C
Schleppgeschwindigkeit / Dragging speed	6.5 mm/sec.
2. Zuführmenge / Second feeding volume	25 mm
3. Zuführmenge / Third feeding volume	145 mm
Zuführgeschwindigkeit / Feeder speed	4.5 mm/sec., 6.5 mm/sec.
Stiftabstand Gerätekontakte / Device pin distance	2 mm pitch
TH-Lötaugengröße / TH land size	0.8 mm
Platinenstärke / Board thickness	1.6 mm
Anzahl der Kontakte / Number of pins	40 pins

Lötunkte mit SR-HS  
Solder points with SR-HS



Lötunkte mit  
herkömmlichem Lot  
Solder points with  
standard solder



## SR-HS im Vergleich / in comparison

### TH-Lötttest (Punktlöten) / TH soldering test (point soldering)

Die hervorragenden Benetzungseigenschaften zeigen sich in einem Vergleich von einem Almit-Lot mit SR-HS-Flussmittel und einem herkömmlichen Lot.

The excellent wetting properties are shown in a comparison between an Almit solder with SR-HS flux and a standard solder wire.

Test-Methode: Schlepplöten durch Lötroboter auf Leiterplatte mit Steckerleiste (Punktlöten)

Test method: drag soldering by an automatic machine onto a PW board with insert parts (point soldering)

Lötkolbentemperatur / Solder iron temperature	340 °C
1. Zuführmenge / First feeding volume	3 mm
Zuführgeschwindigkeit / Feeder speed	10 mm/sec.
Lötzeit / Holding time	0.2 mm/sec.
2. Zuführmenge / Second feeding volume	4 mm
Zuführgeschwindigkeit / Feeder speed	10 mm/sec.
Lötzeit / Holding time	0.5 mm/sec.
TH-Lötaugengröße / TH land size	1.0 mm
Platinenstärke / Board thickness	1.6 mm
Anzahl der Kontakte / Number of pins	10 pins

Lötpunkte mit SR-HS  
Solder points with SR-HS



Benetzung / Wetting



Lötpunkte mit herkömmlichem Lot  
Solder points with standard solder



Benetzung / Wetting



### Überprüfung des Zustands der Flussmittelreste nach dem Löten / Check of the condition of the flux residues after soldering

Test-Methode: Schlepplöten durch Lötroboter auf Leiterplatte mit Steckerleiste

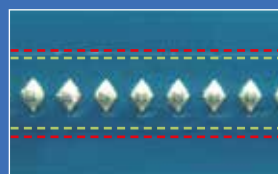
Test method: drag soldering by an automatic machine onto a PW board with insert parts

Lötkolbentemperatur / Solder iron temperature	360 °C
Schleppgeschwindigkeit / Dragging speed	6.5 mm/sec.
2. Zuführmenge / Second feeding volume	25 mm
3. Zuführmenge / Third feeding volume	145 mm
Zuführgeschwindigkeit / Feeder speed	4.5 mm/sec., 6.5 mm/sec.
Stiftabstand Gerätekontakte / Device pin distance	2 mm pitch
TH-Lötaugengröße / TH land size	0.8 mm
Platinenstärke / Board thickness	1.6 mm
Anzahl der Kontakte / Number of pins	40 pins

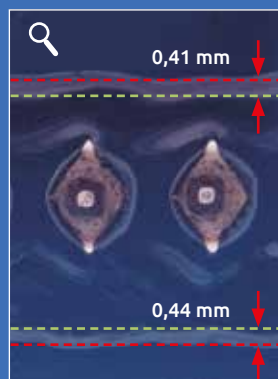
--- Bewegungsbereich des LötKolbens /  
Iron movement area

- - - Flussmittelausbreitung /  
Flux floating

Lötpunkte mit SR-HS  
Solder points with SR-HS



Nahaufnahme / Close-up



Lötpunkte mit herkömmlichem Lot  
Solder points with standard solder



Nahaufnahme / Close-up

